

株式会社テラプローブ 決算説明資料

2013年3月期 第2四半期

2013年3月期第2四半期 業績説明

今回の発表の概要

メモリ事業

- テスト時間の長いモバイル向けDRAMはQoQ売上増だが、YoYでは売上減
- テスト時間の短い汎用DRAMはQoQ、YoYとも売上大幅減

システムLSI事業

- テスト受託はQoQでは売上増だが、YoYでは売上減
- ウエハレベルパッケージ(WLP)はQoQでは売上減 (YoYでは純増)



**費用削減を進めるが、売上高の減少を補いきれず
QoQでは減収減益**

2012年度第2四半期 実績

(億円)

		四半期実績前年同期比較			四半期実績前四半期比較		
		1H/FY2011	1H/FY2012	YoY増減	1Q/FY2012	2Q/FY2012	QoQ増減
売上高	メモリ	102.5	80.9	-21%	41.1	39.8	-3%
	システムLSI	10.5	34.4	228%	20.0	14.3	-29%
	その他	-0.2	-0.2	—	0.0	-0.2	—
売上高		112.8	115.1	2%	61.2	53.9	-12%
営業利益	メモリ	27.7	12.3	-56%	6.2	6.1	-2%
	システムLSI	-3.6	-0.1	—	1.4	-1.5	—
	その他	-5.7	-7.5	—	-3.8	-3.7	—
営業利益		18.5	4.7	-75%	3.8	0.9	-76%
営業利益率		16%	4%	—	6%	2%	—
当期純利益		9.7	3.6	-63%	2.5	1.1	-56%
当期純利益率		9%	3%	—	4%	2%	—

※3Q/FY2011よりシステムLSI事業にWLPが含まれております

第2四半期実績増減分析(売上高)

1H実績(YoY)

<メモリ事業>

- ・テスト時間の長い製品は、テスト時間の短縮により売上高はやや減少
- ・テスト時間の短い製品は、数量の減少により売上高が大きく減少

<システムLSI事業>

- ・テラミクロスの連結子会社化等によりWLPの売上約24億円増

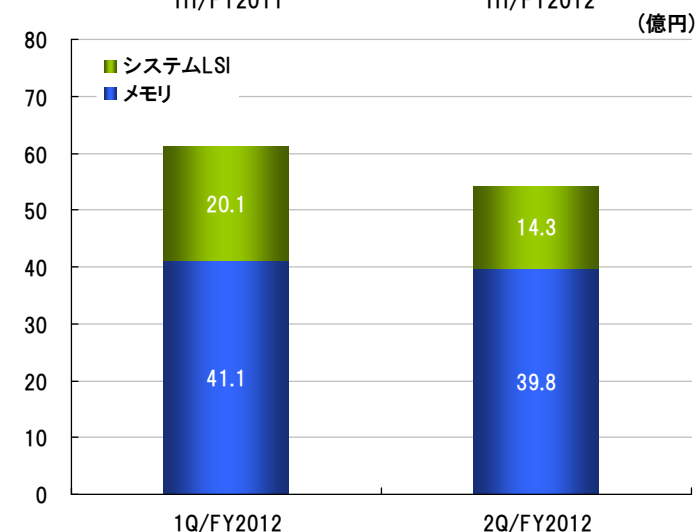
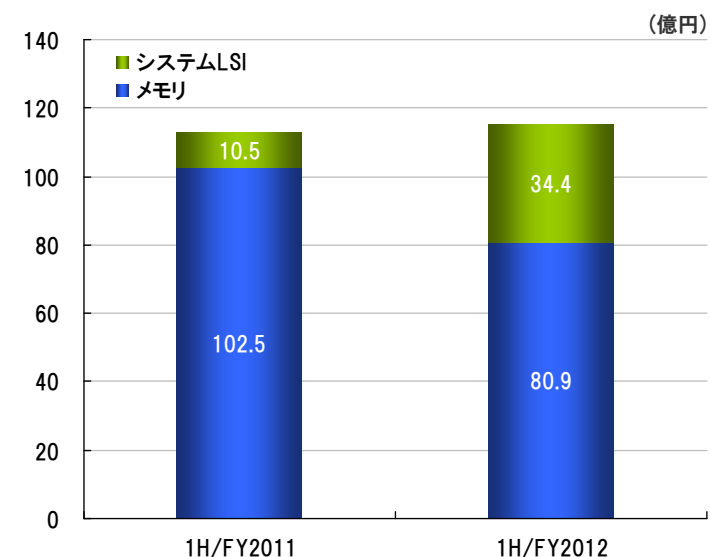
2Q実績(QoQ)

<メモリ事業>

- ・テスト時間の長い製品は売上高が増加したものの、テスト時間の短い製品の売上高減少により約1億円減

<システムLSI事業>

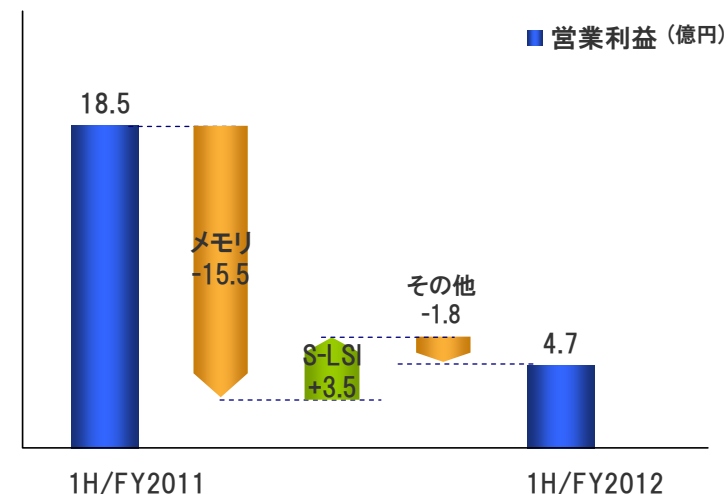
- ・WLPの受託減少等により約6億円減



第2四半期実績増減分析(営業利益)

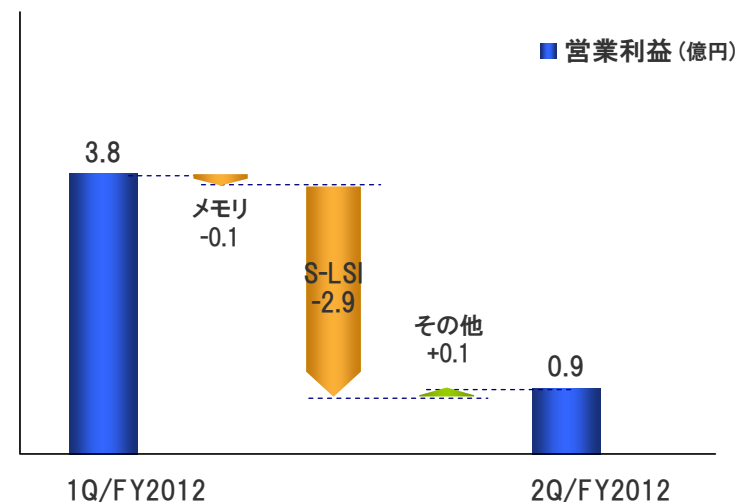
1H実績(YoY)

- ・メモリ事業はDRAM、その他メモリとも売上高減少の影響が大きく、約15億円の損益悪化
- ・システムLSI事業(テスト)は減価償却費の減少と費用削減により損益改善
- ・その他はテラマイクロ子会社化による販管費増



2Q実績(QoQ)

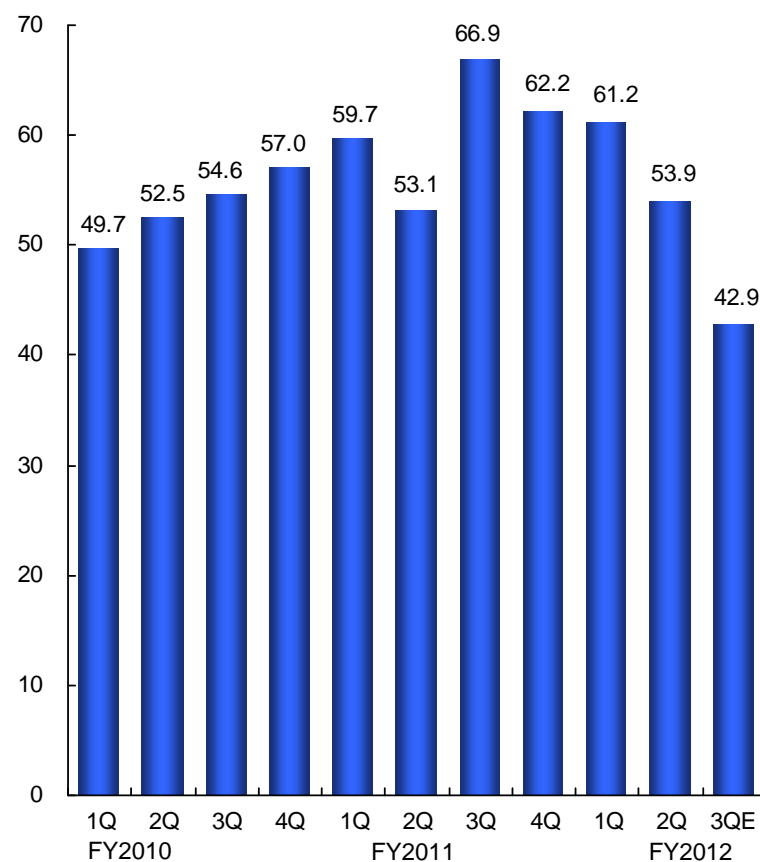
- ・メモリ事業は売上高の減少を費用削減で補い、ほぼ前四半期同等
- ・システムLSI事業はテスト受託で損益が改善したものの、WLPの受託減少を補いきれず損益悪化



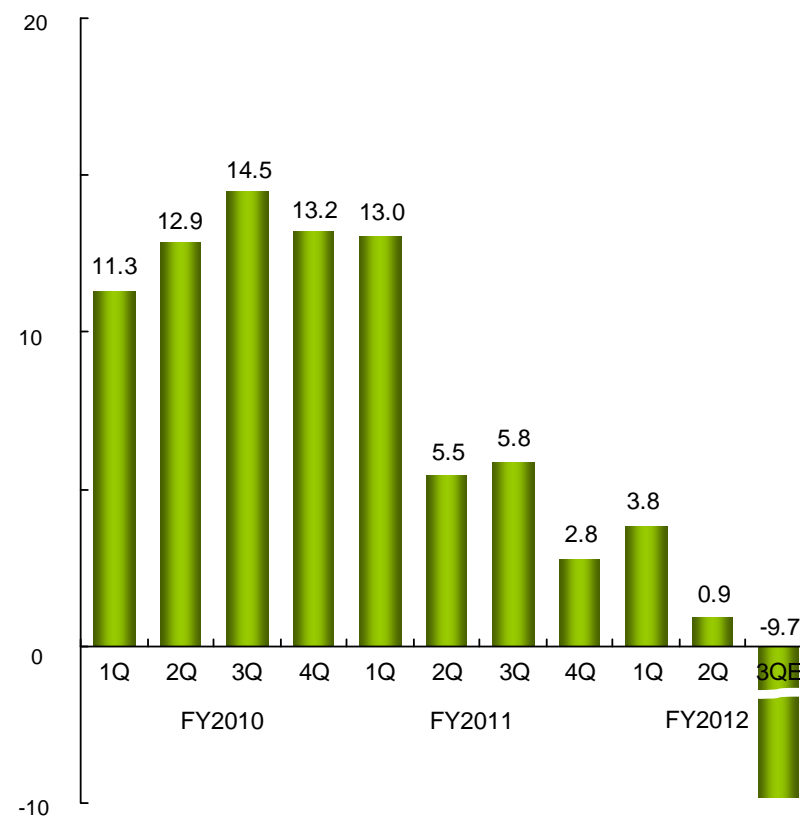
2013年3月期第3四半期業績予想

売上高及び営業利益推移

売上高推移



営業利益推移

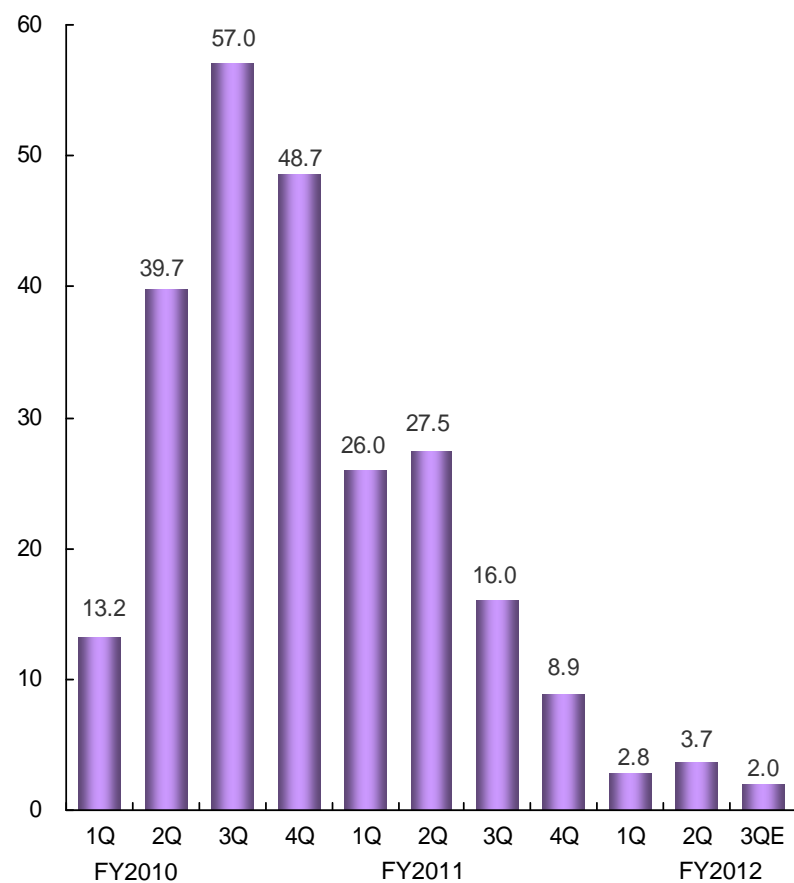


単位: 億円

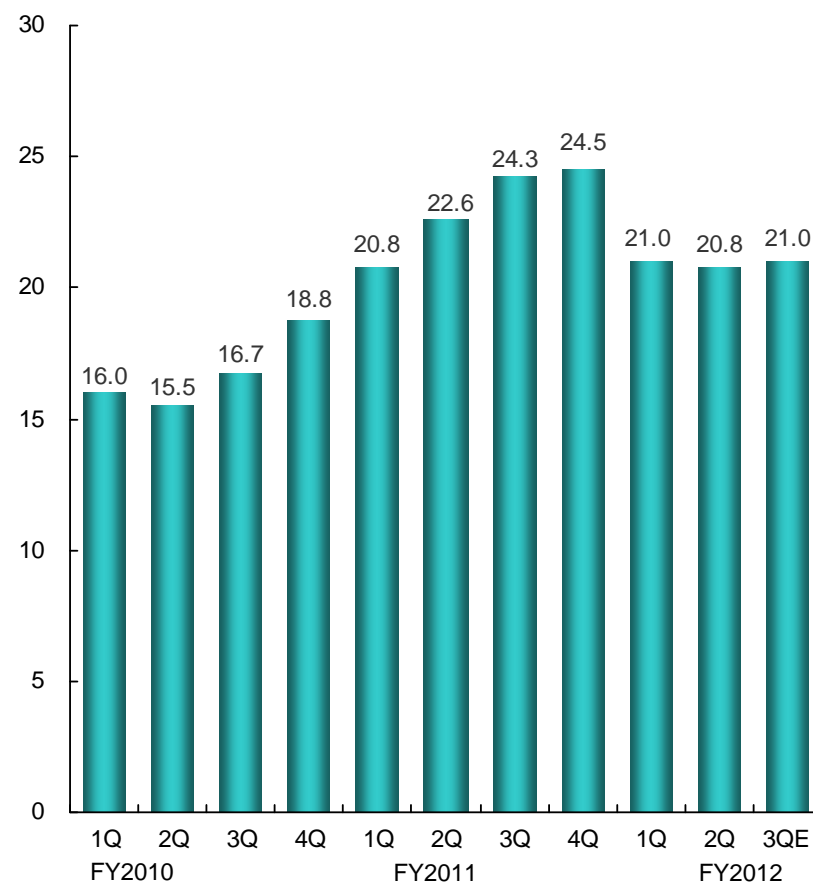
当社グループが属する半導体業界は市場環境が短期間に変化するという特徴があり、1年間の業績予想を作成することが困難であることから、連結業績予想は翌四半期のみを開示することといたします。

設備投資及び減価償却

設備投資額推移



減価償却費推移



単位: 億円

第3四半期業績予想の概要

メモリ事業

- テスト時間の長い製品は2Qに引き続き堅調に推移
- テスト時間の短い製品は2Qと比較してさらに減少

システムLSI事業

- テスト受託は新規受託もあり、2Qに引き続き堅調に推移
- WLP受託は受託量の低迷が2Qから継続



**新規受託の推進、費用削減を進めるが
受託数の減少を補いきれず、減収減益を予想**

第3四半期の取り組み

新規分野の開拓

- メモリ製品のファイナルテスト受託を開拓
- メモリ製品のWLP化へのチャレンジ
- LED素子のテスト受託拡大
- 国内半導体メーカーの台湾サプライチェーン構築をサポート

ターンキービジネスの拡大

- WLP+テストの一貫生産による低コスト、短TATサービスの提供
- 海外パートナーとのターンキービジネス推進

低稼働設備の整理と人員配置の最適化

- 低稼働設備、旧型設備の廃棄・売却の促進
- グループ全体での人員の最適配置



**グループ一丸となったビジネス開拓を促進し
収益の安定化を目指す**

会社説明資料

会社概要

社 名	株式会社 テラプローブ（英文名称:Tera Probe, Inc.）
本 社 所 在 地	神奈川県 横浜市 港北区 新横浜二丁目7番17号
代 表 者	代表取締役社長 渡辺 雄一郎 代表取締役副社長 小平 広人
設 立	2005年8月
事 業 内 容	<ul style="list-style-type: none"> ・ メモリ事業 (DRAM等のメモリ製品のウエハテスト、ファイナルテスト、 開発受託及びWLP受託) ・ システムLSI事業 (SoC、イメージセンサ、アナログ等の各種半導体製品 のウエハテスト、ファイナルテスト、開発受託及びWLP受託)
資 本 金	11,823百万円
連 結 子 会 社	TeraPower Technology Inc.（半導体ウエハテスト受託） 株式会社テラミクロス（ウエハレベルパッケージ受託）
従 業 員 数	295名(単体)、666名(連結)

2012/9末現在

事業拠点

The map shows the locations of Tera Probe's business bases. Red dots indicate the locations: Taiwan (New Taipei City), Kyushu (Nobeoka), Hiroshima (Hiroshima), and Japan (Yokohama, Aoyama, Nobeoka, Hiroshima). Blue lines connect these dots to their respective detail boxes.

海外拠点 (台湾)

TeraPower Technology Inc. (台湾新竹縣)

●台湾のテスト拠点

国内拠点

本社・開発センター (神奈川県横浜市)

Teramikros (東京都青梅市)

●WLPの生産拠点

九州事業所 (熊本県葦北郡)

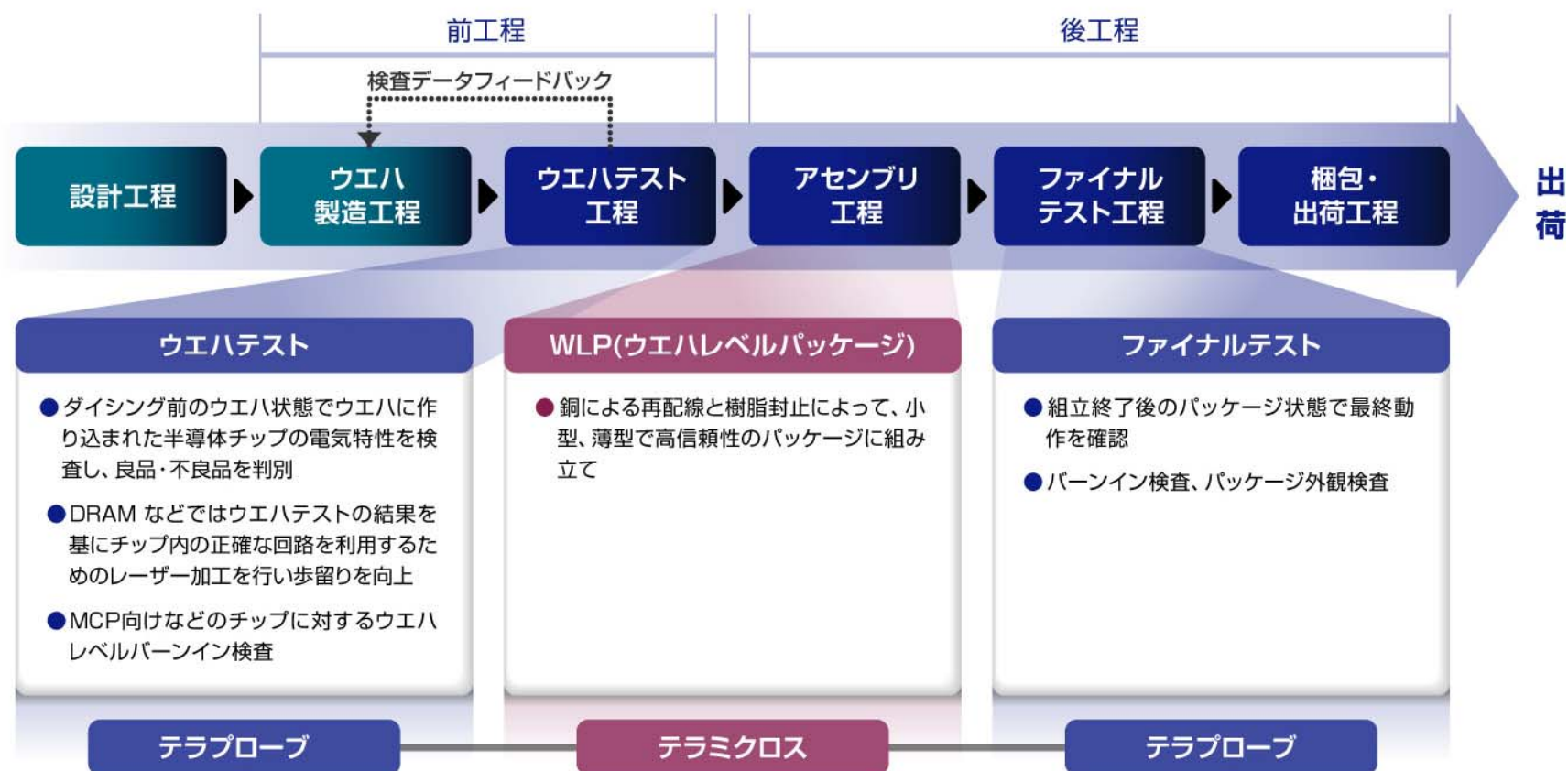
●SoC、イメージセンサ、アナログ等のテスト拠点

広島事業所 (広島県東広島市)

●メモリ系のテスト拠点

半導体製造工程における当社事業の役割

- テストオペレーションの他、治工具の設計、テストプログラムの開発、製品レイアウトへのアドバイスまで
- 半導体製造のバックエンド（後工程）ターンキーサービスにより、顧客の利便性を向上



バックエンドターンキーサービスとは、顧客がウエハ検査後の全ての工程を一括で委託することで、品質、納期等の管理を一元化できるサービスです。

本資料における注意事項等

- 本資料は投資家の参考に資するよう、株式会社テラプローブ(以下、弊社)の現状を理解していただくために作成したものです。
- 本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢及び弊社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。
- 投資を行う際は、必ず弊社が作成する「平成25年3月期第2四半期決算短信」をご覧ください。また、投資家ご自身の判断において行っていただきますよう、お願いいたします。

【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】

株式会社テラプローブ
コーポレートプランニング・IR部門

TEL (045)476-5711

URL <http://www.teraprobe.com>